Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon M580 CPU-Modul, 6040 Level 6 DIO + RIO, 64 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks (X80 & Quantum)

BMEP586040

EAN Code: 3606485440057

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Prozessormodul

Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	8
Lokale E / A-Prozessorkapazität (diskret)	6.144 E/A
Lokale E / A-Prozessorkapazität (analog)	1.536 E/A
Anzahl der anwendungsspezifischen Kanäle (lokales Gestell)	216
anwendungspezifischer E/A	Genaue Zeitstempelung Motion Control SSI-Encoder HART Serielle Schnittstelle Zähler
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B
Anzahl entfernter E/A-Stationen	31 - 2 Einbaugehäuse pro Remote-Station (RIO drop)
Anzahl verteilter Geräte	64
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	6 Ethernet-Kommunikationsmodul 16 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	RIO-Scanner DIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 64 MB für Programm und Daten
Anwendungsstruktur	1 zyklisch/periodische Master Task 128 Ereignis-Tasks 1 periodische Fast Task 2 Hilfs-Tasks

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Cybersicherheit	Achilles-zertifiziert DoS-Abwehr IPSec SNMP-Logging Syslog-Protokollunterstützung Transport-Layer-Security Autit Trail (logging) Integrierte Firewall Firmware-Signatur Passwortschutz Härtung Sichere Kommunikation (HTTPS) Sicherheitsprotokoll
Anzahl der Anweisungen pro ms	40 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 50 Kinst/ms 100 % boolesch
Stromaufnahme	300 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	775000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 Gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2.000 - 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	CE UL CSA RCM EAC Handelsmarine UKCA
Normen	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Schnittstelle Typ 1 und Typ 2 EN/IEC 61850-3, Standort G
Umgebungseigenschaften	Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO)
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	17,500 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	875,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,738 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**250 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**66 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**184 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

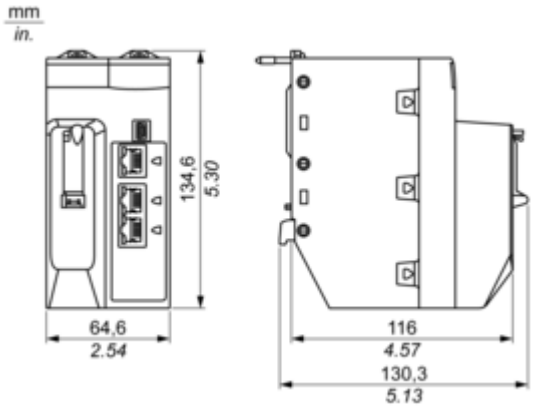
Use Again

Reproduktion

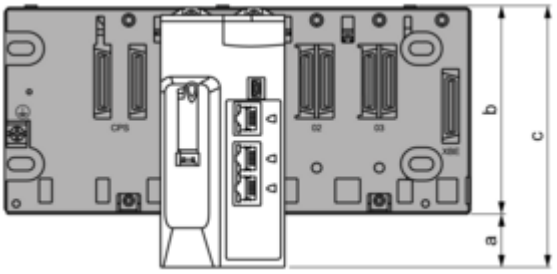
Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Nur CPU-Module

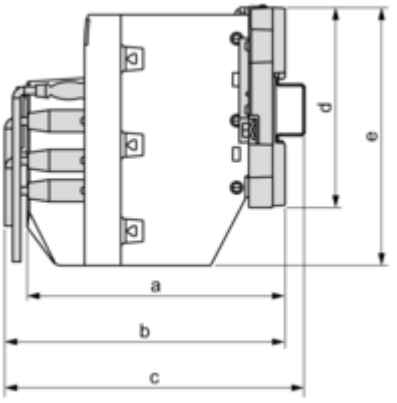


Auf Racks montierte Module



a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)

Image of product / Alternate images

Alternative








M580



